



## G-151无卤有机介质浆料

### 概述:

G-151 是一款**无卤环保型**有机聚合物介质浆料, 用于厚膜电路、片式电阻等电子元器件的包封。该产品工艺稳定性好、固化膜附着强度高, 具有优异的绝缘性、抗湿性,抗酸碱腐蚀力强, 耐溶剂性好, 长期可靠性高。

### 主要技术指标:

项 目	测试方法	技术指标
色 态	目测	黑色、均匀浆状
粘 度 (Pa·s)	BROOKFIELD SC4-14 10RPM , 25°C	90±10
固化膜抗湿性	水煮,8Hr	无明显变化
固化膜耐酸性	5%H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 溶液, 浸泡30min	无明显变化

### 推荐工艺与使用说明:

印刷丝网: 200 ~ 325目不锈钢丝网、乳胶厚度 5 ~ 15μm,

印刷刮板: 聚氨酯刮板, 硬度60 ~ 80 ,

印刷膜厚度: 10-15μm

清 洗 剂: 783慢干水

干燥条件: 180°C, 5 min

固化条件: 200°C-30 min      固化条件可依据用户使用具体条件和需求适当调整

粘度调整：最好使用专用稀释剂稀释，用量不超过1%。

储存条件：贮藏于5-10°C冷藏柜中，保质期6个月。

使用建议：浆料未开封条件下充分回温，印刷前用刮刀搅拌均匀；

产品使用场地洁净、通风良好。